

平成 25 年 11 月 26 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 テ ラ プ ロ ー プ
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 渡 辺 雄 一 郎
(コ ー ド 番 号 : 6 6 2 7) 東 証 マ ー ジ ン
問 合 せ 先 執 行 役 員 C F O 神 戸 一 仁
(T E L 0 4 5 - 4 7 6 - 5 7 1 1)

世界初、WLP・バンプ向けインクジェットコーターを共同開発

株式会社石井表記と株式会社テラプロープは、ウエハレベルパッケージ(WLP)とバンプ向けに、厚膜絶縁塗布材料(ポリイミド)をインクジェット方式で塗布するインクジェットコーターを半導体業界では世界で初めて共同開発いたしました。

従来、WLP やバンプ製造工程における絶縁膜塗布工程はスピコーターでの塗布が主流でした。今回共同開発したインクジェットコーターは、対象ウエハに超微小化した絶縁材料を直接吹き付けることにより、同じ材料で膜厚を容易に変更することを可能としました。さらに、従来のスピコーターでは不可欠な洗浄工程が不要となり、高い生産性を実現しております。

当インクジェットコーターの主な特徴は以下のとおりです。

1. 従来のスピコーターで使用しているポリイミド材を共用でき、高品質、高効率の塗布が可能。
2. 200~300mm ウエハに対応し、膜厚をフレキシブルに調整することが可能。
3. 凹凸の大きい再配線表面にも塗布が容易で、均一性にも優れている。

当社はこれらの特徴を既存製品及び将来製品へ順次展開し、今後も市場のニーズに適合するWLP並びにバンプを提供してまいります。

以上